

株式会社 野毛電気 工業



代表取締役
佐藤 中則

エレクトロニクス分野で
独自のめっき技術と特殊
加工技術でリードする

神奈川県
横浜市金沢区福浦2-10-1

1950年(昭和25年)設立
TEL 045-701-5810

<http://www.nogeden.co.jp/>

電子部品に対する表面処理加工、プレス・精密伸線・圧延加工などの技術を保有し、国内初の独自マスクング技術による精密ストライプめっきを実現。また、それらの技術を複合し、世界初量産のめっきボンディングワイヤを開発。

電子部品加工における総合的な技術力を保有

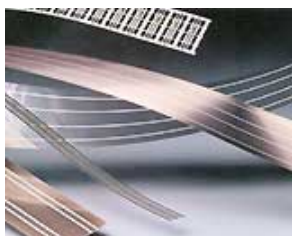
同社は、電子部品機能表面貴金属めっき、電子部品のプレス加工・圧延・伸線などの特殊加工技術を保有するとともに、その技術を複合技術として応用し、電子部品における総合的な加工技術を保有していることで、大手電機メーカーと不可分の関係を構築し、エレクトロニクス分野において確固たる地位を確立している。特に、国内で初めて、独自のマスクング技術による自社開発連続フープ材めっき装置により、精密スポットめっき幅0.5ミリのストライプめっきを実現し、IC及び接点用フープ材への銀めっきを実施している。本技術は、従来になかったPEEK材ベルトをマスクとして用いることで、エンドレスに使用できるメリットを有し、環境に優しい製造方法としての社会貢献もしている。

世界初量産のめっきボンディングワイヤの開発

めっき加工技術と細線製造技術の複合技術によって、銅の芯材にパラジウムめっき加工した世界発量産のめっきボンディングワイヤを開発・販売している。半導体で使用される直径20~80 μ mのボンディングワイヤは、シリコンチップとリード線をつなぐ血管のような役割を持ち、半導体では欠かせない材料である。ゴールドボンディングワイヤを約45年前に国内で初めて製品化した同社では、省資源、材料費低減、高機能などを目指し、新規ボンディングワイヤの開発を行い、従来のゴールドボンディングワイヤより、純金を使用しないことで20~70%のコストダウンを実現し、同等以上の高性能を保有し、現状の製造ラインをそのまま移行して使用できる製品として販売している。

ウエハー上へのめっき技術を開発

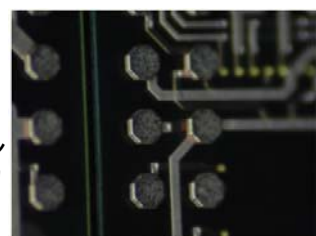
ウエハーレベルパッケージ上へのめっき加工を多様なデバイスにおいてUBM加工処理・再配線加工処理を行い、究極のパッケージ製法を確立して量産を行っている。



ストライプ・
スポット
Agめっき



めっきボン
ディングワ
イヤ



ウエハー
レベル
CSP